

VDEC だより

2022年
3月15日
第42号

- ◆ 2022年度チップ試作日程予定
- ◆ 2021年度分の各種報告書のお願いについて
- ◆ ドイツIHP Solutions社BiCMOSプロセス試作について
- ◆ 春のCAD講習会を開催

東京大学 工学系研究科附属システムデザイン研究センター
基盤設計研究部門・基盤デバイス研究部門
(大規模集積システム設計教育研究センター)

同じ内容は

<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/Tayori/>
にも掲載されています。



VDECからの大事なお知らせです。

◆ 2022 年度チップ試作日程予定

<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/CHIP/ChipApply.html>

設計締切	試作完了	試作ラン
2022/2/28	2022/6/17	Rohm 0.18um
2022/3/7	2022/8/27	Renesas 65nm SOTB
2022/3/28	2022/6/27	OnsemiSanyo 0.8um
2022/6/27	2022/10/14	Rohm 0.18um
2022/7/25	2023/1/21	Renesas 65nm SOTB
2022/9/5	2022/12/23	Rohm 0.18um
2022/9/26	2022/12/19	OnsemiSanyo 0.8um
2022/10/24	2023/2/11	Rohm 0.18um
2023/2/27	2023/6/16	Rohm 0.18um
2023/3/6	2023/8/26	Renesas 65nm SOTB
2023/3/27	2023/6/26	OnsemiSanyo 0.8um

日程は変更となる場合がありますことをご了承下さい。

2021 年度分の各種報告書のお願いについて

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。例年、CAD 利用状況アンケート、チップ試作レポート、論文リストの提出をお願いして頂いておりますが、2021 年度分について WEB での提出受付を間もなく開始いたします。詳細については以下のページをご参照ください。

☆ 2021 年度 CAD 利用状況アンケート提出ページ (近日受付開始)
<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/cadenq.html>

☆ 2021 年度チップ試作レポート提出ページ (近日受付開始)
<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/nenpo.html>

☆ 2021 年度 VDEC 関連論文リスト提出ページ (近日受付開始)
<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/ronbun.html>

提出期限： 2022 年 5 月 11 日(水)

◆ ドイツIHP Solutions社BiCMOSプロセス試作について

<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/CHIP/IHP/IHP2022.html>

東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター(d.lab)は、2020年8月にドイツIHP Solutions GmbHとのFrame Agreementを締結し、IHP Solutionsから提供される以下のMPWシャトルについてd.lab経由での試作が可能となりました。

対象プロセス情報

IHP Technology Name	Short Description
SG13S	A high-performance 0.13um BiCMOS with npn-HBTs up to $f_T/f_{max}=250/340\text{GHz}$, with 3.3V I/O CMOS and 1.2V logic CMOS
SG13G2	A 0.13um BiCMOS technology with much higher bipolar performance of $f_T/f_{max}=300/500\text{GHz}$
SG13G2Cu	A 0.13um BiCMOS technology front end of line with bipolar performance of $f_T/f_{max}=300/500\text{GHz}$ and Cu BEOL from XFab (access to this technology requires bilateral NDA among a customer and XFab)
SG25H5EPIC	A monolithic photonic BiCMOS technology combining 0.25um CMOS, high-performance npn HBTs ($f_T/f_{max}=220/290\text{GHz}$), and full photonic device set for C/O-band

設計プロセスに関するNDA等の締結およびデザインキット提供等の手続きについては、各大学・研究室毎に直接IHP Solutions社とのやりとりをしていただく事となります。下記URLに記載の情報をご参照のうえ、直接コンタクトを取って下さいますようお願いいたします。

d.lab 経由での試作の際は、本学と試作費用の支払いに関して単価契約を結んでいただきます。また、輸出許可申請等、海外への設計データ提供に必要な輸出管理法令に関わる手続きについては各大学にて適切に対処していただくこととなります。

◆ 春の CAD 講習会を開催

<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/CAD/CADTraining.html>

3月にCAD講習会を開催中でございます。合計353名の皆様に登録頂きました。

3月4日(金)

3月8日(火), 3月9日(水)

3月11日(金)

3月15日(火), 3月16日(水)

3月29日(火)

On demand

On demand

On demand

Cadence Innovus 講習会

Cadence Layout (GXL, EAD) 講習会

Cadence EMX 講習会

Cadence SKILL 講習会

Synopsys TCAD Q&A Meeting

Synopsys Design Compiler

Synopsys ICC-II

Synopsys TCAD